臺灣機械產業出口市場動能評析報告

精密機械研究發展中心 2026 年 9 月

從我國機械產業 1 至 8 月出口統計數據觀察，各分項產業呈現不同發展態勢，以下將就目前相關資料及各分項產業出口表現進行分析，以供參考。

壹、 臺灣機械產業出口狀況

2026 年 1 至 8 月臺灣機械產業出口總額為 194.7 億美元，同期成長 16.51%。2026 年 1 至 7 月臺灣機械產業出口總額為 167.85 億美元，較去年同期成長 16.69%。總體成長率差異甚小。

2026 年 1 至 8 月機械產業出口金額前三大為美國(出口金額 50.89 億美元，占比 26.14%，同期成長 14.03%)、中國大陸(出口金額 39.96 億美元，占比 20.52%，同期成長 9.54%)、新加坡(出口金額 15.71 億美元，占比 8.07%，同期成長 91.33%)。對新加坡出口大增反映當地擴大半導體產業投資帶動設備需求成長，日本排名第四，依次有荷、韓、越、德、印度等。

臺灣機械產業整體出口持續展現強勁成長動能。從 1-8 月出口表現觀察，主要由半導體設備、工業機器人及機械零組件支撐，半導體設備維持四成以上成長，工業機器人增幅擴大，為機械產業主要成長來源。2026 年 1 至 8 月臺灣半導體與平面顯示器設備出口總額為 48.49 億美元，同期成長 44.18%。

出口金額前三大國家為中國大陸(出口金額 11.52 億美元，占比 23.75%，同期成長 4.99%)、新加坡(出口金額 11.28 億美元，占比 23.25%，同期成長 135.59%)與美國(出口金額 6.27 億美元，占比 12.93%，同期成長 47.15%)，依次有荷、日、韓等。

臺灣半導體與平面顯示器設備出口成長，受惠於全球半導體業者持續擴大先進製程及 AI 相關晶片產能投資。全球晶圓廠為分散供應鏈風險，加速推動「China+1」及在地化布局，帶動美、日、新等地半導體設備需求增加。

2026 年 1 至 8 月臺灣工業用機器人出口總額為 1 億美元同期成長 26.05%。出口金額前三大國家中國大陸(出口金額 2,188 萬美元占比 21.86%，

同期成長 13.8%)、美國(出口金額 2,106 萬美元占比 21.05%，同期成長 47.26%)與以色列(出口金額 1,613 萬美元占比 16.12%，同期成長 44.03%)。

工業用機器人主要受惠於全球 AI、半導體與電子製造業擴大投資，帶動晶圓廠、封裝測試、伺服器及電子組裝產線加速導入自動化設備；同時全球缺工、工資上升與製造業回流推動企業以機器人提升生產效率，加上半導體供應鏈持續向東南亞與美國等地布局，帶動臺灣機器人及關鍵零組件出口增加，尤其馬來西亞等 AI 半導體封測聚落需求大幅成長，推升整體出口表現。

2026 年 1 至 8 月臺灣機械零組件出口總額為 20.42 億美元，同期成長 8.43%。出口金額前三大國家為中國大陸(出口金額 9.15 億美元，占比 44.79%，同期成長 12.83%)、美國(出口金額 3.25 億美元，占比 15.94%，同期衰退 2.83%)與日本(出口金額 1.17 億美元，占比 5.71%，同期成長 1.93%)。臺灣機械零組件出口受惠於全球 AI 基礎建設與半導體設備投資熱潮帶動精密零組件、傳動元件與自動化設備需求增加，加上供應鏈在地化與分散趨勢使國際客戶增加對臺採購，惟增幅低於整機設備，反映零組件出口受庫存調整與部分傳統產業需求放緩影響。

2026 年 1 至 8 月臺灣工具機出口總額為 13.25 億美元，同期衰退 1.9%。出口金額前三大國家為中國大陸(出口金額 3.64 億美元，占比 27.49%，同期成長 0.91%)、美國(出口金額 2.16 億美元，占比 16.32%，同期衰退 5.14%)與印度(出口金額 1.03 億美元，占比 7.78%，同期成長 12.54%)。工具機受全球製造業投資放緩、中國大陸市場需求疲軟及地緣政治影響，加上主要客戶庫存調整與應用產業(如汽車、一般機械)資本支出保守，惟 AI 相關設備與高階數控工具機需求仍具支撐，整體呈現傳統市場萎縮與新興需求分化格局。

2026 年 1 至 8 月臺灣木工機出口總額為 2.7 億美元，同期衰退 15.58%。出口金額前三大國為美國(出口金額 1.49 億美元，占比 55.43%，同期衰退 27.9%)、中國大陸(出口金額 2,505 萬美元，占比 9.29%，同期成長 1.29%)、泰國(出口金額 1,728 萬美元，占比 6.41%，同期成長 144.41%)。出口受美國房市與建築投資趨緩、家具及木材加工業者資本支出保守，加上全球貿易不確定性與中國大陸低價競爭等影響，導致海外設備更新需求減弱，呈現明顯出口衰退。泰國受到家具產業新廠建置設備需求推動，臺灣出口成長。

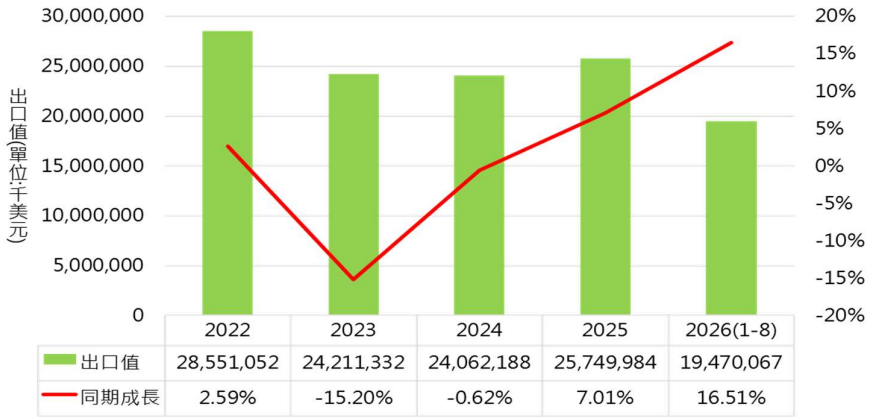
2026 年 1 至 8 月臺灣橡塑膠機出口總額 4.59 億美元，同期衰退 16.83%。出口金額前三大國為中國大陸(出口金額 6,727 萬美元，占比 14.67%，同期衰退 4.64%)、越南(出口金額 5,171 萬美元，占比 11.28%，同期衰退 16.65%)與印尼(出口金額 4,836 萬美元，占比 10.54%，同期成長 14.60%)。在全球景氣復甦平緩下民生消費品與包裝需求疲軟，下游塑膠製品廠延緩大型設備採購。8 月日圓位於低點提升價格競爭力；歐盟趨嚴永續減塑法規企業陷入轉型期。終端需求不振匯率劣勢與價格競爭下，使橡塑膠機出口衰退。

2026 年 1 至 8 月臺灣製鞋機出口總額 4,072 萬美元，同期衰退 6.44%。出口金額前三大國家為越南(出口金額 1,697 萬美元，占比 41.68%，同期成長 3.48%)、印尼(出口金額 1,487 萬美元，占比 36.52%，同期衰退 9.91%)與印度(出口金額 414 萬美元，占比 10.16%，同期成長 4.31%)。

2026 年 1 至 8 月臺灣食品包裝與加工機出口總額 2.9 億美元，同期衰退 7.08%。出口金額前三大國家為美國(出口金額 6,135 萬美元，占比 21.15%，同期衰退 6.41%)、中國大陸(出口金額 2,612 萬美元，占比 9%，同期衰退 27.3%)與日本(出口金額 1,904 萬美元，占比 6.56%，同期衰退 11.19%)。

2026 年 1 至 8 月臺灣紡織機出口總額為 1.94 億美元，同期衰退 12.77%。出口金額前三大國家為中國大陸(出口金額 4,848 萬美元，占比 24.98%，同期成長 4.75%)、越南(出口金額 3,768 萬美元，占比 19.41%，同期成長 4.91%)與印度(出口金額 1,286 萬美元，占比 6.63%，同期衰退 32.98%)。

單位: 千美元



	2022	2023	2024	2025	2026(1-8)
出口值	28,551,052	24,211,332	24,062,188	25,749,984	19,470,067
同期成長	2.59%	-15.20%	-0.62%	7.01%	16.51%

圖 1　我國機械產業近年出口金額變化

資料來源：財政部貿易統計資料查詢系統，PMC 整理，2026/9

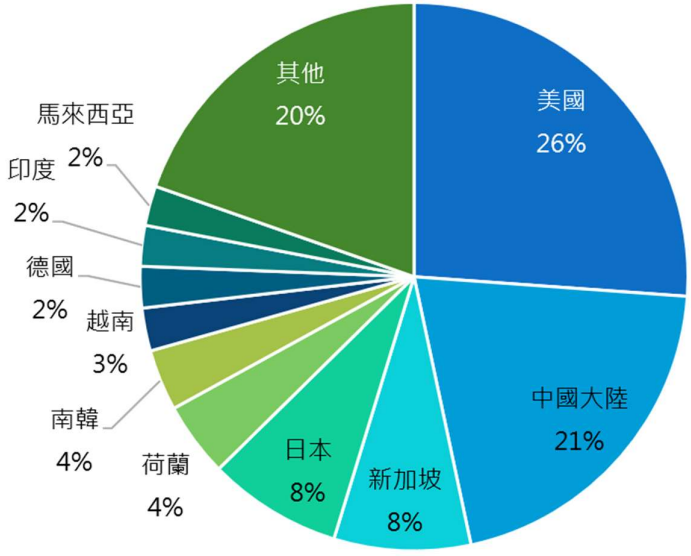


圖 2　2026 年 1-8 月國家別機械業出口占比

資料來源：財政部貿易統計資料查詢系統，PMC 整理，2026/9

2026 年 1-8 月機械產品出口金額合計達 194.7 億美元，同期成長 16.51%。成長率較佳之產品包含:半導體設備、工業用機器人、機械零組件等。出口較弱的產品中工具機衰退 1.9%；橡塑膠機、食品包裝與加工機、木工機械、紡織機、製鞋機，衰退幅度從-6.44%延伸至-16.83%有待改善。

表 1　我國機械產業出口成長率及占比

單位: 億美元

產業別	1-8 月出口	同期成長率	占比	1-7 月出口	同期成長率	占比
機械產業	194.7	16.51%	100%	167.85	16.69%	100%
半導體設備	48.49	44.18%	24.90%	42.04	44.51%	25.05%
機械零組件	20.42	8.43%	10.49%	17.71	9.03%	10.55%
工具機	13.25	-1.90%	6.81%	11.56	-1.47%	6.89%
橡塑膠機	4.59	-16.83%	2.36%	3.96	-16.34%	2.36%
食品包裝與加工機	2.9	-7.08%	1.49%	2.51	-7.71%	1.50%
木工機械	2.7	-15.58%	1.39%	2.36	-16.11%	1.41%
紡織機	1.94	-12.77%	1.00%	1.66	-16.50%	0.99%
工業用機器人	1.0	26.05%	0.51%	0.844	24.82%	0.50%
製鞋機	0.41	-6.44%	0.21%	0.359	-7.51%	0.21%

資料來源: 關務署，PMC 整理

貳、 機械產業國際動態

1. 台積電、英特爾、三星力挺 ASML，攜手投入下一代 12 吋光罩技術

ASML 與台積電於 9 月 7 日宣布產業合作推動升級至 12 吋光罩，擬將 High NA EUV 微影技術價值發揮到極致，目標於 2031 年前建立 12 吋光罩試產線，並於 2033 年前實現微影系統就緒以支援先進製程量產。三星電子及 Intel 亦加入 12 吋光罩研發計畫。將現行 6 吋光罩，升級至 12 吋光罩，將提升晶圓廠的生產力、降低晶片製造成本，並消除在 High NA EUV 曝光時所受限制。台積電表示產業攜手解決複雜問題能開創無限可能，期許透過創新降低門檻，持續傳遞尖端技術的價值。

三星除加入 12 吋光罩倡議平台外，更規劃於 2028 年率先將 High NA EUV 導入下一代 DRAM 大規模量產，Intel 則導入部分晶片生產。三星主要目的為延續 DRAM 微縮路線圖、簡化部分製程、提升生產效率，亦推動 12 吋光罩發展；凸顯三星整合記憶體與晶圓代工雙重製造架構的全球競爭策略。

發展 12 吋光罩需要多項創新技術: 1)大尺寸多層鍍膜與均勻控制技術、2)大尺寸光罩 3D 效應與圖形失真補償、3)奈米級電子束圖形寫入控制技術、4)耐高功率 EUV 護膜、5)特殊重力與機械應力防變形技術等。在 12 吋生產設備上幾乎相關機台都須重新更換或客製化。如電子束光罩寫入機、大尺寸超高精度缺陷檢測與修補設備、大型光罩清洗機、量測對準設備、大尺寸光罩傳送盒與傳輸系統等。顯示出需要各廠商持續參與，並非 2-3 年可以完成。

參、 臺灣工具機產業動態

2. 程泰集團與新代科技攜手攻智慧製造解析

程泰集團與新代科技於 2026 年 6 月 10 日舉行「程泰集團×新代科技策略合作備忘錄簽署儀式」。由程泰集團楊德華會長與新代科技蔡尤鏗董事長共同簽署。備忘錄主要內容:

1) 全球製造業發展趨勢: 製造業朝智慧化、自動化與彈性生產發展，工具機產業競爭由單一設備性能，轉向智慧製造系統整合能力。

2) 雙方合作方向: 將深化工具機、自動化、機器人應用與智慧製造技術，聚焦 AI 伺服器供應鏈、機器人零組件、新能源車及高階精密加工需求等高成長產業需求。透過機台本體、自動化方案、應用驗證與市場導入，協助客戶導入智慧化生產模式。

3) 合作落實方式: a) 程泰集團具備完整工具機產品線與全球市場通路；b) 新代集團長期投入工具機控制、自動化、工業機器人及智慧製造技術。c) 雙方將結合產品、技術與市場資源，推動高效率與高價值的智慧製造解決方案。d) 針對各類工具機設備，導入自動上下料、機械手臂、標準化周邊模組與通用介面。e) 協助客戶提升生產效率、降低人力需求，適應少量多樣、快速換線與無人化生產需求等。f) 依備忘錄，推動合作深化與落實，包括技術驗證、應用推廣及市場拓展等，完善合作機制與協作模式。g) 透過智慧製造、自動化與機器人等關鍵技術整合應用，促進廠商、產業升級與價值鏈延伸。h) 強化臺灣工具機與智慧製造產業於全球市場之競爭力與影響力。

3. 未來產業發展方向

1) 臺灣工具機業者合作突破困境

市場趨勢已經走到 AI 驅動、智慧製造，臺灣在相關領域應用必須超越競爭國家，在受國外供應受限下，尋求臺灣內部合作自行發展控制器已刻不容緩。新代等國內業者推廣本地化介面、對話式編程與遠端診斷等功能之控制平台。朝向智慧加工、生產可視化、資料串流等方向發展，技術能力已獲得肯定，智財權掌握於國內廠商中，並與下游業者建立協同開發合作關係。

新代在中國大陸工具機控制器市場已站穩腳步，中國為台商最重要業務來源，拓展大陸市場使用新代控制器易於被市場接受，可以較低價格拓展中國市場，擴大商機。

工具機系統業者思維，中低階工具機在中國市場採用 PC-based 產品可降低成本，歐美高階工具機適時採用國外控制器。

2) 產官學界加速推動控制器發展

政府透過「工具機搭載國產控制器跨域整合計畫」，補助臺廠在手工具、自行車等終端產業導入新代、寶元或工研院研發控制器，建立自主產業鏈。

發展 PC-Based 開放式架構，避開他國封閉式控制器控制，利用臺灣 ICT 與半導體、AI 運算硬體優勢，開發具差異化、智慧化軟體服務，提供智慧製造解決方案。